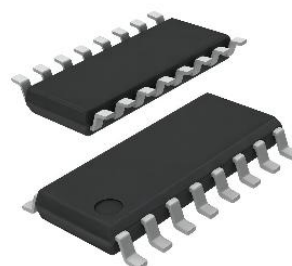


HX2003-S/HX2003-P

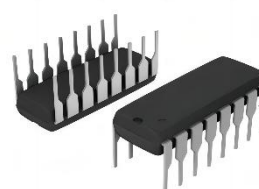
HX2003-S/HX2003-P 为七达林顿阵列，耐压高，且集成了输出嵌位保护二极管，应用于继电器阵列驱动等驱动线路。

特点

- ESD 能力: 4000V
- 各路独立地。
- 输出嵌位保护二极管泄放速度快，且各路一致性好。
- 输出驱动足 500mA，且各路一致性好。
- 采用 SOP-16 或 DIP-16 封装。

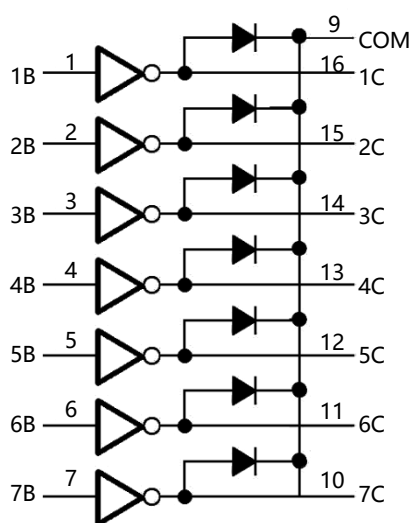


SOP-16

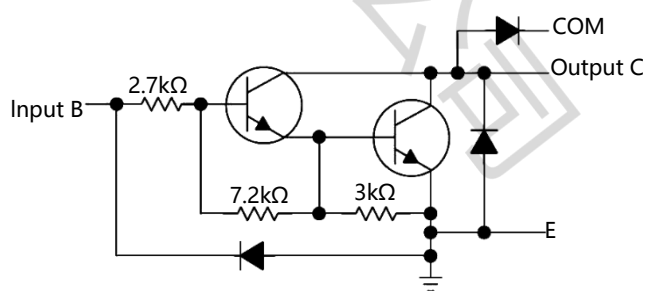


DIP-16

引出端排列图及管腿定义



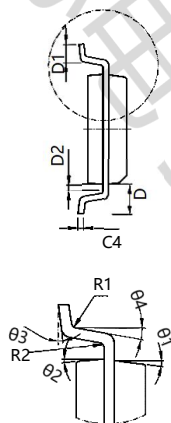
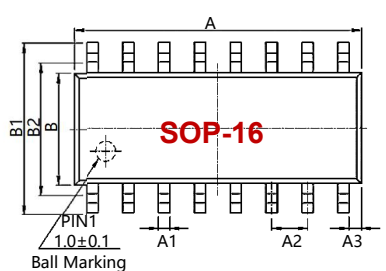
单元电路图



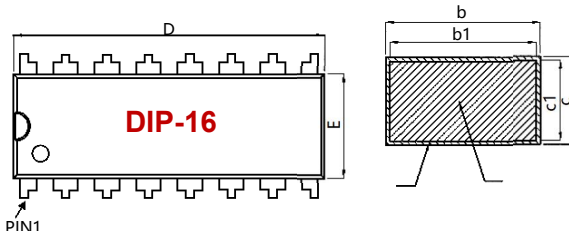
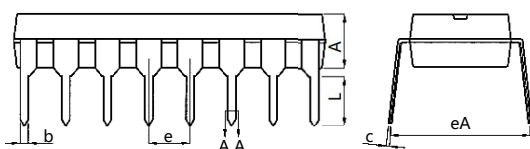
电参数表

参数名称	参数符号	测试条件	TA= +25°C			单位	
			最小	典型	最大		
接触测试	OS	-100uA test OS GND	-1.0	-0.55	-0.3	V	
集电极关断电流	I_{CEX}	$V_{CE}=50V; I_I=0$			15	μA	
输入端开启电流	$I_{I(ON)}$	$V_I=3.85V$	0.6	0.9	1.2	mA	
输入端开启电压	$V_{I(ON)}$	$V_{CE}=2V$	$I_C=200mA$	0.6	1.0	1.4	V
			$I_C=250mA$	1.0	1.4	1.8	
			$I_C=300mA$	1.2	1.6	2.0	
CE 饱和压降	$V_{CE(SAT)}$	$I_I=250uA$	$I_C=100mA$	0.6	0.9	1.2	V
		$I_I=350uA$	$I_C=200mA$	0.7	1.0	1.4V	
		$I_I=500uA$	$I_C=350mA$	0.9	1.3	1.7	
嵌位二极管反向漏电	I_R	$V_R=50V$			15	μA	
嵌位二极管正向压降	VF	$I_F=350mA$	1.0	1.6	1.9	V	

封装信息



Mark	Size	Min(mm)	Max(mm)	Mark	Size	Min(mm)	Max(mm)
A	9.80	10.00	C4	0.203	0.233		
Al	0.356	0.456	D	1.05TYP			
A2	1.27TYP		D1	0.40	0.70		
A3	0.302TYP		D2	0.15	0.25		
B	3.85	3.95	R1	0.20TYP			
B1	5.84	6.24	R2	0.20TYP			
B2	5.00TYP		Ø1	8°~12° TYP4			
C	1.40	1.60	Ø2	8°~12° TYP4			
Cl	0.61	0.71	Ø3	0°~8°			
Cp	0.54	0.64	Ø4	4°~12°			
C3	0.05	0.25					



Symbol	millimeter		
	Min	Nom	Max
A	3.20	3.30	3.40
b	0.44		0.53
b1	0.43	0.46	0.49
c	0.25		0.30
c1	0.24	0.25	0.26
D	18.95	19.05	19.15
E	6.25	6.35	6.45
e	2.54BSC		
eA	8.30	8.80	9.30
L	3.00		

Part Number	Package Type	Package	quantity
HX2003-S	SOP-16	Taping	1000
HX2003-P	DIP-16	Taping	500